

博彦科技股份有限公司 关于公司资产解除抵押的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次抵押情况概述

2015年5月，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1420号文核准，发行了总额为1亿元的公司债券（以下简称“15博彦债”）。上述公司债券采用资产抵押担保的增信方式，以公司所拥有的北京市海淀区中关村软件园二期（西扩）G-1地块的博彦科技软件园研发中心项目用地土地使用权及其地上在建工程提供抵押担保。具体内容详见《博彦科技为发行公司债券提供土地及建筑物抵押担保手续完成的公告》（公告编号：2015-010）。

二、抵押解除情况

15博彦债于2018年5月26日期满三年，公司于2018年5月28日完成了兑付兑息工作。具体内容详见《博彦科技2015年公司债券兑付兑息暨摘牌公告》（公告编号：2018-041）。

截至本公告披露日，上述资产的抵押解除手续已办理完毕。

三、备查文件

（一）《不动产权证书》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2018年7月5日